

# 募集要項

## 企業データ

### 社名

DOWAホールディングス株式会社

### 所在地

〒101-0021  
東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル 22F

### 創業

明治17(1884)年

### 資本金

364億3,600万円

### 代表者

代表取締役社長 河野 正樹

### 従業員数

約3,500名(連結)

### 売上高(2006年3月期)

3,163億8,800万円(連結)

### 経常利益(2006年3月期)

331億7,700万円(連結)

### 事業内容

- ①非鉄金属製錬事業
- ②総合環境リサイクル事業(廃棄物処理、貴金属リサイクル、汚染土壌回復)
- ③電子材料事業(半導体材料、磁性材料、電池材料ほか)
- ④金属加工事業
- ⑤工業炉、熱処理事業

### 事業所

本社、名古屋営業所、大阪営業所、九州営業所、浜松営業所  
研究所/製錬技術研究所、金属材料研究所、半導体材料研究所、  
磁性材料研究所、電子材料研究所、環境技術研究所、開発センター  
工場/横浜、真岡、塩尻、浜松、安城、半田、豊田、滋賀、岡山ほか  
海外/ニューヨーク、デトロイト、バンクーバー、メキシコ、シンガポール、  
インド、上海、蘇州

## 採用データ

### 採用予定数

技術系:40名 事務系:10名

### 職種

技術系/研究開発、生産技術開発、製造、技術スタッフ  
プラント設計、生産管理、品質管理 ほか

事務系/企画、営業、経理、人事、法務 ほか

### 勤務時間

本社/9:00~17:25(フレックスタイム制)  
事業所/8:00~16:00 ほか(勤務地による)

### 勤務予定地

本社、各研究所、各事業所、海外 ほか

### 初任給

修士了:249,000円 学部卒:225,000円 高専卒:196,500円  
(\*06.4月実績 住宅手当含む)

### 諸手当

通勤費(全額支給)、超過勤務手当、住宅手当、教育手当 ほか

### 昇給・賞与

昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(6月、12月)

### 寮・住宅

本社、各研究所、各事業所など勤務地周辺に完備

### 休日・休暇

週休2日、祝祭日、メーデー、創立記念日、年末年始、  
有給休暇(10~22日)、慶弔休暇、特別休暇、リフレッシュ休暇 ほか

## 応募について

### 選考方法

面接(専門、人事)、適性検査、健康診断

### 試験日

応募次第、随時(1月から順次実施いたします)

### 交通費

当社規定により支給

### 応募方法

学科(教授)推薦応募:提出書類を揃え、ご郵送ください  
自由応募:採用ホームページ上でご確認ください  
URL: <http://www.dowa.co.jp/saiyou/>

### 提出書類

当社指定履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、教授推薦書、健康診断書  
(院生の方は、学部時の成績証明書、卒業証明書も提出ください)  
現在取り組んでいる研究テーマをまとめたレジュメ(A4用紙1~2枚)

### 交通手段

JR秋葉原駅、地下鉄日比谷線秋葉原駅 徒歩5分

### 書類提出先

〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル 22F  
DOWAホールディングス株式会社  
人事部門 部長 山田 健昭

担当 古賀・長江  
フリーダイヤル:0120-268862  
ダイヤルイン:03-6847-1102  
E-Mail: [saiyou@dowa.co.jp](mailto:saiyou@dowa.co.jp)